**第33回　電子デバイス・電子部品の信頼性シンポジウム発表論文募集**

**（主テーマ）　先端部品・デバイスの故障物理、信頼性評価技術、故障解析技術、Pbフリーはんだ実装技術、KGD技術、マルチチップモジュール（MCM）の信頼性評価技術、等**

**応募要領**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **１．論文の　内容** | **：** | **上記の主テーマの他、電子部品、半導体デバイス、及び電子機器の信頼性評価技術、故障解析事例など** | **６．会場** | **：** | **東京都大田区産業プラザ**  **交通アクセス**  **京浜急行・空港線/京急蒲田駅より徒歩２分**  JR**京浜東北線/蒲田駅より徒歩１２分** |
| **２．応募資格** | **：** | **当センターの賛助会員会社の社員及び協賛団体の会員、並びに運営委員会等のご推薦がある方** | **７．申込　　 締切** | **：** | **2023年7月7日（金）** |
| **３．発表時間** | **：** | **原則として、討論を含めて1件30分**  **以内** | **８．発表**  **論文**  **原稿**  **締切** | **：** | **2023年10月6日（金）**  **発表論文申込書の選考の結果、発表をご依頼することになった方には、７月下旬迄に原稿作成要領をお送りしますから期限内にご提出願います。** |
| **４．開催期日** | **：** | **2023年11月9日（木）～10日（金）** |
| **５．申込方法** | **：** | **下記の「発表論文申込書」の様式に所要事項を記入の上、お早めにお申し込み下さい。** | **９．参加費** |  | **発表者からも参加費（5000円）を頂くことにしました。ご協力をお願いします。** |

**申込先及び問合わせ先**

**一般財団法人　日本電子部品信頼性センター**RCJ**信頼性シンポジウム事務局**

**〒111-0043　東京都台東区駒形2-5-6　カミナガビル3階**

**TEL：03-5830-7601、FAX:03-5830-7602、URL: http://www.rcj.or.jp**

**宛先　RCJ信頼性シンポジウム事務局宛　　 E-mail： shiono@rcj.or.jp**

**第33回　電子デバイス・電子部品の信頼性シンポジウム発表論文申込書**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **論文題名**  **和文：**  **英文：** | | | | | **分　類（記入不要）** |
|  |
| **発**  **表**  **者** | **氏名** | **和文：**  **英文：** | TEL |  | |
| FAX |  | |
| E-mail |  | |
| **企業名** |  | | | |
| **所属** |  | | | |
| **所在地** | **〒** | | | |
| **発**  **表**  **内**  **容** |  | | | | |